（上接A13版）

人员自第七届董事会第十二次会议召开日起至本次交易实施完毕期间，不存在股份减持计划。

十三、保护中小投资者合法权益的相关安排

为保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司在本次重组中采取以下安排和措施：

（一）严格履行上市公司信息披露的义务

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组管理办法》等相关法律、法规的要求对本次交易方案采取严格的保密措施，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

（二）严格履行相关程序

公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行相关程序。公司将聘请具有证券业务资格的审计机构、资产评估机构对标的资产进行审计和评估，将聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，并将对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，确保本次交易公允、公平、合法、合规，不损害上市公司股东利益。

本次交易构成关联交易，在召集董事会、股东大会审议相关议案时，关联董事、关联股东应回避表决，独立董事应当事先认可并发表独立董事意见。

（三）股东大会及网络投票安排

本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议将以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人将就列入本次股东大会审议事项的议案逐项进行表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。

（四）资产定价公允性

本次交易中，公司将聘请具有证券业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估。资产评估机构在评估过程中将实施相应的评估程序，遵循客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。

标的资产的最终交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，经由交易双方协商并另行签署补充协议予以确定。待审计、评估工作完成后，公司独立董事将对评估定价的公允性发表独立意见。

（五）股份锁定安排

本次交易完成后，交易对方认购的士兰微新增股份的限售期将按照中国证监会相关规定由交易双方另行约定。

（六）其他保护投资者权益的措施

上市公司、交易对方及标的公司承诺保证提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。

十四、待补充披露的信息提示

本次交易相关审计、评估工作尚未完成。本预案中涉及的财务数据、预估结果仅供投资者参考之用，最终数据以审计机构出具的审计报告、资产评估机构出具的评估报告为准。标的公司经审计的财务数据、资产评估情况将在重组报告书中予以披露。

重大风险提示

一、与本次交易相关的风险

（一）本次交易被暂停、终止或取消的风险

由于本次交易将受到多方因素的影响且方案的实施尚需满足多项条件，本次交易的时间进度存在不确定性，可能因为以下事项的发生而面临被暂停、终止或取消的风险：

1、尽管上市公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而被使本次交易被暂停、终止或取消的风险。

2、本次交易推进过程中，市场环境的可能变化、监管机构的审核要求均可能对本次交易方案产生影响，交易双方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善本次交易方案，如交易双方无法就调整和完善交易方案的措施达成一致，则存在被暂停、终止或取消的风险。

3、本次交易过程中可能出现目前不可预知的重大影响事项，而被暂停、终止或取消的风险。

上述情形均可能导致本次交易面临被暂停、终止或取消的风险。如果本次交易需重新进行，则交易将面临重新定价的风险，提请投资者注意。

（二）本次交易的审批风险

截至本预案出具日，本次交易方案尚需经公司董事会、股东大会通过、交易对方内部权力机构及按照中国法律规定其他相关有权机构（如有）批准，并经中国证监会核准。本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间尚存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

（三）审计、评估工作尚未完成的风险

截至本预案出具日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本预案中涉及的财务数据仅供投资者参考之用，最终数据以具有证券相关业务资格的审计机构、资产评估机构出具正式审计报告、评估报告为准。标的资产经审计的财务数据、资产评估情况将在重组报告书中进行披露。标的资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。

（四）预估值及交易作价尚未确定的风险

截至本预案出具日，鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易作价尚未确定。本次交易标的资产的交易价格将以具有证券相关业务资格的资产评估机构出具正式审计报告、评估报告为准。标的资产经审计的财务数据、资产评估情况将在重组报告书中进行披露。标的资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。

（五）与募集配套资金相关的风险

1、募集配套资金的审批风险

本次交易中，公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。前述配套资金将用于8英寸集成电路芯片生产线二期项目和补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务。募集配套资金事项尚需董事会批准、股东大会批准、中国证监会审核，提请投资者注意募集配套资金的审批风险。

2、募集配套资金的发行风险

在中国证监会核准后，受股票市场变动、监管政策导向等因素影响，可能引起本次募集配套资金金额不足乃至募集失败。如实际募集资金金额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决，从而对本次重组的整合绩效产生不利影响，提请投资者注意募集配套资金的发行风险。

3、募集配套资金的实施风险

本次交易募集配套资金将用于8英寸集成电路芯片生产线二期项目和补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务，在募集资金投资项目的建设过程中，可能面临政策变化、技术进步、市场供求、成本变化等诸多不确定因素。因此，配套募集资金投资项目存在未能如期实施，或实施效果与预期值产生偏离的风险，提请投资者注意相关风险。

二、与标的公司经营相关的风险

（一）行业周期性波动风险

半导体行业具有较强的周期性特征，与宏观经济整体发展亦密切相关，目前，由于新型冠状病毒肺炎疫情、贸易摩擦等因素导致全球经济增速存在一定下滑趋势，使得全球半导体产业发展的不确定性进一步增大，也将对包括标的公司在内的行业内企业的经营业绩造成一定的影响。特此提醒投资者关注半导体行业周期性及收入波动风险。

（二）产业政策变化风险

半导体产业作为信息产业的基础，是国民经济和社会发展的战略性产业。近年来，国家出台了一系列鼓励政策以推动我国半导体产业的发展，增强产业创新能力和国际竞争力。如果未来国家相关产业政策支持力度减弱，标的公司的经营业绩将会受到不利影响。特此提醒投资者关注产业政策变化对标的公司经营业绩的风险。

（三）新产品开发风险

半导体消费终端产品市场更新速度较快，标的公司的发展在一定程度上依赖于识别并快速响应客户需求的变化，以开发出符合客户要求且具有较好成本效益的产品，也因此面临着新产品开发的风险。如果标的公司的创新不能紧跟市场产品创新的节奏，将发生较多的资源浪费并丧失市场机会，同时，不能为标的公司的发展提供新的动力。特此提醒投资者关注新产品开发风险。

（四）持续大额资金投入风险

半导体行业具有技术强、投入高、风险大的特征。标的公司为持续保证竞争力，需要在研发、制造等各个环节上持续不断进行资金投入，8吋线的建设需要大额的资本开支及研发投入。特此提醒投资者关注持续大额资金投入风险。

三、财务风险

截至本预案出具日，本次交易标的资产仍处于引损状态。同时，受宏观经济、行业政策、竞争环境等多方面未知因素的影响，标的公司在经营过程中存在经营风险、市场风险，可能对标的公司的经营成果产生重大影响，因此不排除标的公司未来实际取得的经营成果低于预期的情况。

本次重组实施后，上市公司总股本规模将有所增加，若标的公司盈利能力低于预期，上市公司未来每股收益短期内可能会下滑，每股回期回报可能被摊薄，特此提醒投资者关注本次重组可能摊薄回期回报的财务风险。

四、其他风险

（一）股票价格波动风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受上市公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，上市公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，上市公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后，上市公司将严格按照《股票上市规则》的规定，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者做出正确的投资决策。

（二）不可抗力风险

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素给上市公司带来不利影响的可能性，提请广大投资者注意相关风险。

（三）疫情风险

新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的防控措施仍在延续，对士兰集昕的生产经营可能有一定的影响。目前疫情发展态势仍未稳定，尤其是海外疫情的持续恶化，使集成电路行业原辅材料及相关生产设备的供应可能会出现延迟交货、限制供应或提高价格的情况。如果士兰集昕不能及时获得充足的原辅材料、设备和备件供应，正常生产经营可能会受到不利影响。提请投资者注意本次交易中疫情所导致的投资风险。

第一章交易概述

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

1、国家政策鼓励企业通过兼并重组做大做强

2010年9月，国务院颁布《国务院关于促进企业兼并重组的意见》（国发[2010]27号），提出要进一步推进资本市场企业并购重组的市场化改革，健全市场化定价机制，完善相关规章及配套政策，支持企业利用资本市场开展兼并重组，促进行业整合和产业升级。支持符合条件的企业通过发行股票、债券、可转换债券等方式为兼并重组融资。鼓励上市公司以股权、现金及其他金融创新方式作为兼并重组的支付手段，拓宽兼并重组融资渠道，提高资本市场兼并重组效率。

2014年3月，国务院印发《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发[2014]14号），强调兼并重组是企业加强资源整合、实现快速发展、提高竞争力的有效措施，是化解产能严重过剩矛盾、调整优化产业结构、提高发展质量效益的重要途径。同时明确提出将取消下放部分审批事项、简化审批程序、优化信贷融资服务，完善有利于并购重组的财税、土地、职工安置政策等多项有力措施，大力支持企业通过并购迅速做大做强。

2018年11月，证监会修订并发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》，进一步鼓励支持上市公司并购重组，提高上市公司质量，服务实体经济，落实股票停复牌制度改革，减少简化上市公司并购重组预案披露要求。

2019年10月，证监会修订并发布了《重组管理办法（2019年修订）》，旨在准确把握市场规律，理顺重组上市功能，发挥资本市场服务实体经济功能作用，是落实全面深化资本市场改革总体方案的重要举措。

2020年3月，证监会发布了《关于修改部分证券期货规章的决定》，进一步完善上市公司并购重组制度。其中，修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》进一步明确了上市公司控股股东、实际控制人违法违规行为的法律责任，明确了发行股份购买资产在欺诈的法律责任，依法扩大证券支付工具范围，对证券交易所相应板块的授权规定进行概括性调整，为深化市场化改革预留空间。

上述一系列文件鼓励企业通过资产注入方式做优做强上市公司，鼓励企业通过兼并重组方式进行资源整合。综上，本次交易系在符合国家支持并购重组的相关政策背景下而推进。

2、本次交易符合国家相关产业政策

2000年6月国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发[2000]18号），首次专门针对软件和集成电路产业制定了鼓励政策，对集成电路行业的发展具有重要意义。

2010年10月国务院发了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号），提出着力发展集成电路、高端服务器等核心基础产业的决定。

2011年1月国务院下发《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等七个方面为集成电路产业发展提供了更多的优惠政策。

2014年6月，国务院下发《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确提出集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，并决定设立国家产业投资基金，重点支持集成电路制造领域，兼顾设计、封装测试、装备、材料环节，推动企业提升产能水平和实行兼并重组、规范企业治理，形成良性自我发展能力。

2015年6月国务院印发《中国制造2025》发展战略规划，将集成电路作为新一代信息技术产业纳入大力推动突破发展的重点领域，着力提升集成电路设计水平，掌握高密度封装及三维组装技术。

2016年11月国务院下发《十三五国家战略性新兴产业发展规划》（国发[2016]67号），启动集成电路重大生产力布局规划工程，实施一批带动作用强的项目，推动产业能力实现快速跃升。

2018年3月，财政部、国税总局、发改委、工信部联合发布《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2018]27号），对集成电路生产企业所得税优惠政策做了进一步规定和调整。

2019年5月，财政部、税务总局发布《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（2019年5月），对依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

2019年10月30日，国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造等列为鼓励发展行业。

国家一系列法规政策的颁布对集成电路产业的发展提供了强有力的支撑。同时，在国家政策的支持引导下，国内拥有自主知识产权的企业也迎来更大的发展机遇。综上，本次交易系在符合国家支持集成电路产业的政策背景下而推进。

3、大基金对公司集成电路生产线的大力支持

为抓住机遇加快公司集成电路芯片生产线的升级，提高公司产品的综合竞争能力，根据2015年4月22日召开的2014年年度股东大会上审议通过的《关于拟投资建设8英寸集成电路芯片生产线的议案》，公司拟投资建设一条8英寸集成电路芯片生产线（以下简称“8吋线”）。2016年3月18日公司及下属子公司士兰集成、集华投资、士兰集昕等与大基金共同签署了投资协议，根据投资协议大基金将投资6亿元以支持公司8吋线建设。2017年6月底，公司8吋线正式投产，产出逐步增加，2019年8月，为进一步提高芯片产出能力，提升制造工艺水平，士兰集昕拟对8吋线进行技术改造，公司开始建设8吋线二期项目，其中大基金投资6亿元，以支持公司发展。8吋线建设，有力地提升了公司的制造工艺水平，进一步缩小与国际同类型半导体企业之间的差距，并为后期公司加快进入12吋线创造了条件。2017年6月8吋线正式投产至今，8吋线芯片产量持续上升对公司的整体营收增长起了积极推动作用；在国家和地方政府的大力支持下，公司开始向“成为具有自主品牌、具有国际一流竞争力的综合性半导体产品供应商”这一目标迈进。

（二）本次交易的目的

1、本次交易符合上市公司发展战略

公司战略目标是以国际上先进的IDM大厂为学习标杆，争取早日成为具有自主品牌、具有国际一流竞争力的综合性半导体产品供应商。长期以来，公司凭借“设计与制造一体”（IDM）模式，在集成电路、半导体功率器件、MEMS传感器、LED等多个技术领域持续进行生产资源、研发资源的投入，取得了长足的进步。公司通过在多个芯片设计领域的积累，推出了许多有针对性的芯片产品和系统应用解决方案，积极响应了国内客户芯片国产化的需求，特别在白色家电等领域打破了国外厂商的长期垄断。今后，公司还将继续全力推动特殊工艺研发、制造平台的发展，加快8吋线产品技术平台的导入，积极拓展产能。

通过本次交易，公司将增加对标的公司的持股比例和控制力，进一步推动8吋集成电路芯片生产线特殊工艺研发、制造平台的发展，增强公司生产制造能力和未来盈利能力。本次交易符合公司长期发展战略，有利于维护公司全体股东的利益。

2、大基金成为公司直接股东后将提升公司价值

根据国务院印发的《国家集成电路产业发展推进纲要》，大基金是支持国家产业发展战略的产业投资基金，对我国集成电路的产业发展起着引导性作用。引入大基金成为公司的主要股东，有利于提升公司在集成电路产业的市场地位。大基金投资了众多集成电路产业链的上下游公司，而且对所投资的公司具有一定的影响力，能为上市公司带来更多的业务协同。大基金成为公司股东后，不仅能继续对公司8吋线项目的生产和建设提供支持，也能将在资金、产业方面对公司其他产品线提供支持。大基金作为公司重要的股东，未来将持续提升公司的整体价值，从而切实提高公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力。

二、本次交易方案概述

本次交易方案包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分。

（一）发行股份购买资产

本次交易前，上市公司直接持有集华投资51.22%的股权，直接持有士兰集昕6.29%的股权。集华投资为士兰集昕的第一大股东，其直接持有士兰集昕47.25%的股权。

上市公司拟通过发行股份方式购买大基金持有的集华投资19.51%的股权以及士兰集昕20.38%的股权。

本次交易完成后，上市公司将直接持有集华投资70.73%的股权，直接持有士兰集昕26.67%的股权。集华投资对士兰集昕的持股比例保持不变。上市公司将通过直接和间接方式合计持有士兰集昕63.74%的股权。

本次交易标的交易价格尚未确定，标的资产的最终交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，经由交易双方协商并另行签署补充协议予以确定。

本次交易中，上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的董事会决议公告日，即第七届董事会第十二次会议决议公告日。本次发行股份的价格为定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%，即13.62元/股。

本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为士兰控股，实际控制人仍为陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人，本次交易不会导致上市公司控制权和实际控制人发生变更。

（二）募集配套资金

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金金额不超过130,000万元且不超过拟购买资产交易价格的100%；同时，发行股份数不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次交易上市公司向投资者非公开发行股票募集配套资金的发行价格不低于上市公司募集配套资金发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

三、发行股份购买资产

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易发行股份购买资产的发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为上海证券交易所。

（二）发行方式及发行对象

本次交易发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行股票；发行股份对象为交易对方国家集成电路产业投资基金股份有限公司。

（三）标的资产的定价原则及交易价格

本次交易标的资产的交易价格尚未确定，标的资产的最终交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，经由交易双方协商并另行签署补充协议予以确定。评估基准日暂定为2020年7月31日。

（四）对价支付方式

公司拟全部通过发行股份方式向交易对方支付交易对价。

（五）定价基准日和发行股份的价格

根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的上市公司股票交易均价情况如下：

交易均价类型	交易均价（元/股）	交易均价的90%（元/股）
定价基准日前20个交易日	15.60	14.04
定价基准日前60个交易日	15.14	13.62
定价基准日前120个交易日	16.65	14.98

交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%，即为13.62元/股，符合《重组管理办法》的相关规定。

（六）发行股份的数量

本次交易发行股份购买资产中交易对方获得的上市公司新增股份数量以交易双方协商确定的标的资产的最终定价除以发行价格计算。发行数量精确至股，不足一股的部分作舍去处理。

（七）调价机制

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将根据中国证监会、上交所的相关规则进行相应调整。除上述除息、除权事项导致的发行价格调整外，本次交易暂不设置发行价格调整机制。

（八）股份锁定期

本次交易完成后，交易对方认购的士兰微新增股份的限售期，将按照中国证监会相关规定由交易双方另行约定。

（九）交割后标的公司权益归属

本次交易完成后，交易双方按本次交易完成后的股权比例享有标的公司的权益。

（十）业绩补偿承诺

本次交易不设置业绩补偿承诺。

四、募集配套资金

（一）发行股份的种类、面值、上市地点

本次交易发行股份募集配套资金的股份发行种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为上海证券交易所。

（二）发行方式及发行对象

本次交易发行股份募集配套资金的发行方式为向特定对象非公开发行；发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

（三）定价基准日和发行股份的价格

本次募集配套资金的定价基准日为本次发行期首日前，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

（四）发行股份的数量

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金金额不超过130,000万元且不超过拟购买资产交易价格的100%；同时，发行股份数不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

最终发行的股份数量，将在募集配套资金获得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及根据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

（五）股份锁定安排

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份，自股份上市之日起6个月内不以任何方式转让。本次募集配套资金完成后，认购方因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（六）募集配套资金用途

本次交易发行股份募集配套资金用于8英寸集成电路芯片生产线二期项目和补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务。

第二章上市公司基本情况

一、基本情况简介

公司名称	杭州士兰微电子股份有限公司
英文名词	Hangzhou Silan Microelectronics CO., LTD.
股票简称	士兰微
股票代码	600460
法定代表人	陈向东
注册资本	131,206.16万元人民币
成立日期	1997年9月25日
上市日期	2003年3月11日
上市地点	上海证券交易所
统一社会信用代码	91330000025393376Q
注册地址	浙江省杭州市黄姑山路4号
办公地址	浙江省杭州市黄姑山路4号
邮政编码	310012
董事会秘书	陈越
联系电话	0571-88210880
联系传真	0571-88210763
公司网站	www.silan.com.cn
经营范围	电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部批文）。

二、设立及历次股权变动情况

（一）公司设立至首次公开发行并上市

公司前身为杭州士兰电子有限公司，系由陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七位自然人于1997年9月25日以现金方式共同出资设立，注册资本350万元。

2000年4月，经士兰电子1999年度股东会决议通过，士兰电子以未分配利润转增注册资本1,150万元，股东按出资比例同比例增资。同时，股东范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵同意分别将其应转增的注册资本195.5万元中的1.5万元转让给陈向东。经此次增资后，士兰电子的注册资本变更为1,500万元。

2000年10月，经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2000]21号文批准，士兰电子以2000年7月31日为审计基准日整体变更设立为杭州士兰微电子股份有限公司。2000年10月28日，士兰微完成工商登记手续并领取企业法人营业执照。经此次整体变更后，公司设立时的注册资本为7,502万元。

2003年2月17日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]12号文核准，公司采用向沪市、深市二级市场投资者定价配售方式发行了2,600万股人民币普通股（A股）股票，该次发行的人民币普通股于2003年3月11日在上海证券交易所系统挂牌上市交易。该次发行后，公司总股本增至10,102万元。

（二）公司首次公开发行并上市后的股权变更

1、2004年资本公积转增股本

2004年4月23日，经公司2003年年度股东大会决议通过，并经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2004）28号《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司增加注册资本的批复》同意，公司以2003年末股份总数10,102万股为基数，以资本公积金向全体股东按10:10的比例转增股本。该次转增完成后，公司总股本增至20,204万股。

2、2005年股权转让

2004年1月8日，公司的发起人股东陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人签署了《关于设立杭州欣源投资有限公司协议书》，拟将其持有的士兰微64.34%股权（资本公积转增股本后的股数为13,000万股）及现金100万元出资设立杭州欣源投资有限公司。2004年11月5日，经中国证券监督管理委员会证监公字[2004]76号文批准，豁免陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人应履行要约收购义务。2004年12月31日，陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人将其持有的公司13,000万股未上市流通自然人股过户给杭州欣源投资有限公司，该部分股份的性质变更为境内未上市流通法人股，公司股份总数未发生变化。2005年4月8日，士兰微完成工商变更登记。该次股权变动后，杭州欣源投资有限公司持有士兰微13,000万股股权，占股份总数的64.34%，成为士兰微的控股股东。2005年12月19日，杭州欣源投资有限公司更名为“杭州士兰控股有限公司”。

3、2005年股权分置改革

2005年10月24日，经公司召开的股权分置改革相关股东会议通过，并经上海证券交易所上证上字（2005）181号《关于实施杭州士兰微电子股份有限公司股权分置改革方案的通知书》同意，公司通过了股权分置改革方案。根据该方案，公司流通股股东以每10股流通股获得原非流通股股东支付的3.6股作为对价，全体非流通股股东向流通股股东支付的股份总数为18,720,000股。股权分置改革工作完成后，公司原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

4、2006年转增股本、股票分红

2006年4月18日，经公司2005年年度股东大会决议通过，公司以2005年年末股份总数20,204万股为基数，向全体股东每10股派送股票股利2.2股（每股面值1元），并以资本公积金向全体股东每10股转增7.8股。此次转增股本后，公司总股本增至40,408万股。

5、2010年非公开发行股票

2010年9月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1153号《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2010年9月向特定投资者非公开发行3,000万股人民币普通股。本次非公开发行完成后，公司总股本增至43,408万股。

6、2012年资本公积转增股本

2012年6月8日，经公司2011年年度股东大会审议通过，公司以2011年末股份总数43,408.00万股为基数，按每10股转增10股的比例，向全体股东实施资本公积转增股本。该次转增实施完成后，公司总股本增至86,816.00万股。

7、2013年非公开发行股票

2013年9月3日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]688号《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2013年8月向特定对象非公开发行9,120万股人民币普通股。本次非公开发行完成后，公司总股本增至95,936万股。

8、2014年资本公积转增股本

2014年5月21日，经公司2013年年度股东大会审议通过，公司以2013年末股份总数95,936万股为基数，按每10股转增3股的比例，向全体股东实施资本公积转增股本。该次转增实施完成后，公司总股本增至124,716.80万股。

9、2018年非公开发行股票

2018年1月12日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2005号《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2018年1月向特定对象非公开发行64,893,614股人民币普通股。本次非公开发行完成后，公司总股本增至131,206.16万股。

三、前十大股东情况

截至2020年6月30日，公司前十大股东情况如下：

单位：万股

序号	持有人名称	持有人类别	持有数量	持有比例
1	杭州士兰控股有限公司	境内非国有法人	51,350.32	39.14%
2	中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3,107.19	2.37%
3	厦门半导体投资集团有限公司	国有法人	2,127.66	1.62%
4	中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,063.68	1.57%
5	中国银行股份有限公司－国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,315.57	1.00%
6	陈向东	境内自然人	1,234.99	0.94%
7	香港中央结算有限公司	其他	1,127.10	0.86%
8	范伟宏	境内自然人	1,061.39	0.81%
9	国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	889.39	0.68%
10	郑少波	境内自然人	837.46	0.64%
合计		–	65,114.75	49.63%

7、最近三十六个月控制权变动情况

最近36个月内，上市公司控股股东始终为士兰控股，实际控制人始终为陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人，公司最近36个月内控制权未发生变动。

五、最近三年重大资产重组情况

截至本预案出具日，上市公司最近三年未进行重大资产重组。

六、主营业务发展情况

公司为专业从事集成电路、分立器件及LED芯片等半导体产品的设计、生产与销售的综合性半导体企业。公司从集成电路芯片设计业务开始，在形成系统级芯片（SoC）设计能力的同时，逐步建成依托特殊工艺的芯片制造平台，并将技术和制造平台延伸至功率器件、功率模块、MEMS传感器和LED彩色像素管产品等封装领域，在国内确立了独特的竞争优势。

公司主营业务发展情况良好，2017年度、2018年度和2019年度，分别实现营业收入274,179.18万元、302,585.71万元和311,057.38万元。

七、控股股东和实际控制人

（一）控股股东

截至2020年6月30日，上市公司产权控制关系结构图如下：

截至2020年6月30日，上市公司控股股东为士兰控股，士兰控股直接持有公司51,350万股，占公司总股本的39.14%。

（二）实际控制人

截至2019年12月31日，公司实际控制人陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人直接以及通过士兰控股间接持有公司共计43.09%股份。公司实际控制人的，基本情况如下：

陈向东：董事长，男，中国国籍，汉族，1962年2月出生，中共党员，大学本科。1997年至今任公司董事长，同时担任子公司士兰集成、士兰集昕、士兰明芯、士兰光电董事长，集华投资董事长兼总经理，成都士兰、士兰全佳、博脉科技执行董事；在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事长职务。

范伟宏：副董事长，男，中国国籍，汉族，1962年12月出生，中共党员，大学本科。1997年至今任公司副董事长，同时担任子公司士兰集成、士兰集昕、士兰明芯董事兼总经理，成都士兰、士兰全佳总经理，成都士兰执行董事；在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。

郑少波：副董事长兼总经理，男，中国国籍，汉族，1965年1月出生，中共党员，硕士。1997年至今任公司副董事长，2005年3月至今任公司总经理，同时担任子公司士兰集成、士兰集昕、士兰明芯、士兰全佳、美卡乐施董事，深兰微、西安士兰执行董事，士兰光电、集华投资董事；控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。

江忠永：董事，男，中国国籍，汉族，1964年8月出生，大学本科。1997年至今任公司董事，同时担任子公司士兰集成、士兰明芯董事，子公司美卡乐施董事长总经理，成都士兰监事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。

罗华兵：董事，男，中国国籍，汉族，1963年10月出生，大学本科。1997年至今任公司董事，同时担任子公司士兰集成监事；参股企业友旺电子、友旺科技董事兼总经理；天水华天科技股份有限公司监事会主席。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。

宋卫权：监事会主席，男，中国国籍，汉族，1968年12月出生，大学本科，现任公司监事会主席，公司设计所所长。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任监事职务。

陈国华：监事，男，中国国籍，汉族，1963年8月出生，大学本科，现任公司监事，子公司成都士兰副总经理，成都集佳、深兰微监事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任监事职务。

八、本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易标的交易价格尚未确定，且本次交易募集配套资金拟采用询价方式发行，最终发行价格和发行数量尚未确定，因此目前尚无法准确计算本次交易前后上市公司股权变动的具体情况。公司将在审计、评估等工作完成后再次召开董事会，并于重组报告书中详细测算并披露本次交易对上市公司股权结构的影响。

根据目前的交易方案，预计本次交易不会导致上市公司控制权变更。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

九、合法存续情况及其董事、监事、高级管理人员最近三年合规情况

上市公司为合法设立、独立经营的独立法人，上市公司股票已经在上交所挂牌交易。上市公司不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定须终止的情形。

上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚的情况。

上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年诚信状况良好，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，且最近十二个月内也未受到证券交易所的公开谴责。

十、公司主要财务数据及财务指标

（一）最近两年及一期主要财务数据

1、合并资产负